

中国食品科学技术学会

中食学字[2018]第 014 号

关于组团赴印度参加第十九届世界食品科技大会的通知

各地方食品学会、专业分会、团体会员单位、理事、会员，

根据我学会 2018 年度国际交流工作计划安排，并应国际食品科技联盟的邀请，我学会拟于 2018 年 10 月 23-27 日组团赴印度参加在孟买举行的第十九届世界食品科技大会。现将有关事项通知如下：

一、出访目的

世界食品科技大会是由国际食品科技联盟主办，由其在世界各国的成员国组织申办，作为世界上层次最高、最权威的国际盛会，历来受到了国际食品科技界的高度关注。2008 年 10 月，我学会在上海承办了第十四届世界食品科技大会，共有来自世界上 76 个国家和地区的 2200 余名食品科技工作者参会，成为世界食品科技大会历史上参会人数最多、征集论文数量最多的一次，赢得了全球食品科技界的高度称赞和尊重。

由印度科学院承办的第十九届世界食品科技大会将于 2018 年 10 月 23-27 日在印度孟买召开。此次大会的主题为“2025 年每日 250 亿餐：健康，营养，安全，多样 (25 BILLION MEALS A DAY BY 2025 with Healthy, Nutritious, Safe & Diverse FOODS)”。为了进一步巩固我学会对外交流的成果，加强与印度食品科技界的沟通与交流，同时了解国

际食品科技与产业界的最新进展和动向，我学会拟组团参加在印度举办的“第十九届世界食品科技大会”。

二、主要内容

(1) 参加第十九届世界食品科技大会；

(2) 与国际食品科技联盟相关负责人进行交流，落实 2019 年 4 月在中国共同举办的“第十届国际食品安全与健康大会”日程及外方发言人等相关事宜；

(3) 同印度孟买当地企业及科研机构进行交流。

三、访问时间与地点

1、出访时间：2018 年 10 月 23-27 日；

2、访问地点：印度孟买。

四、参团代表条件

1、向大会投递了论文摘要并被接收的人员；

2、其他有参会意向的人员。

五、参团报名

接此通知后，于 2018 年 3 月 20 日前填写《拟派出国人员登记表》后发送到学会指定邮箱。

六、联系方法

联系人：陈铮 但晓雅

通讯地址：北京市海淀区阜成路北三街 6 号轻苑大厦三层，100048

电子邮箱：chenzheng@cifst.org.cn

电 话：010-65265375 转 809 传 真：010-65264731

附件：拟派出国人员登记表

